

絶縁放熱シート

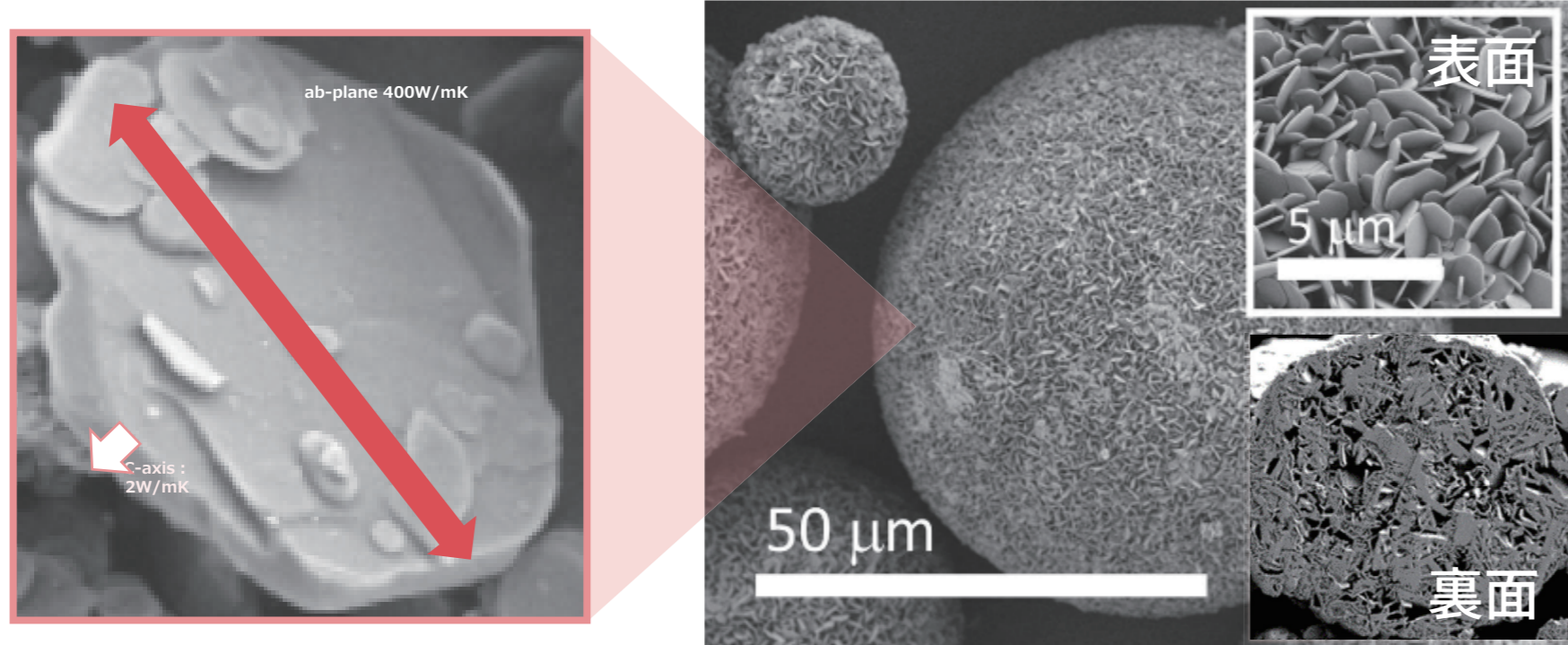
開発品

概要

- ◆ 開発したカードハウス構造窒化ホウ素（BN）凝集粒子は、樹脂と配合することで、**高熱伝導材料**を実現しました。
- 高放熱化により、**省電力化**に貢献
- 小型化が可能で、**省スペース化**に貢献

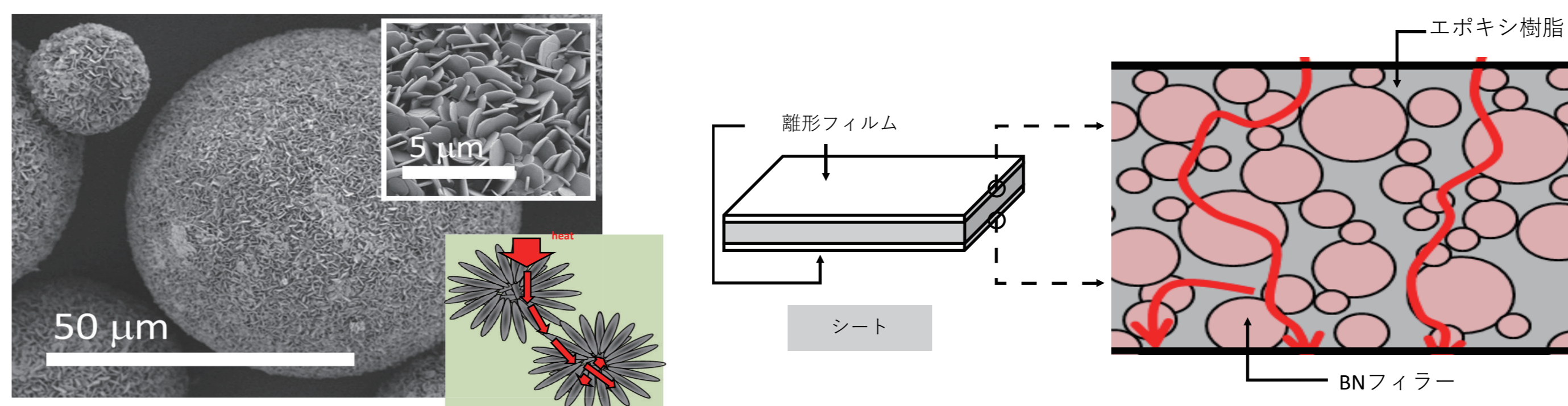
特長

フィラーの構造と物性



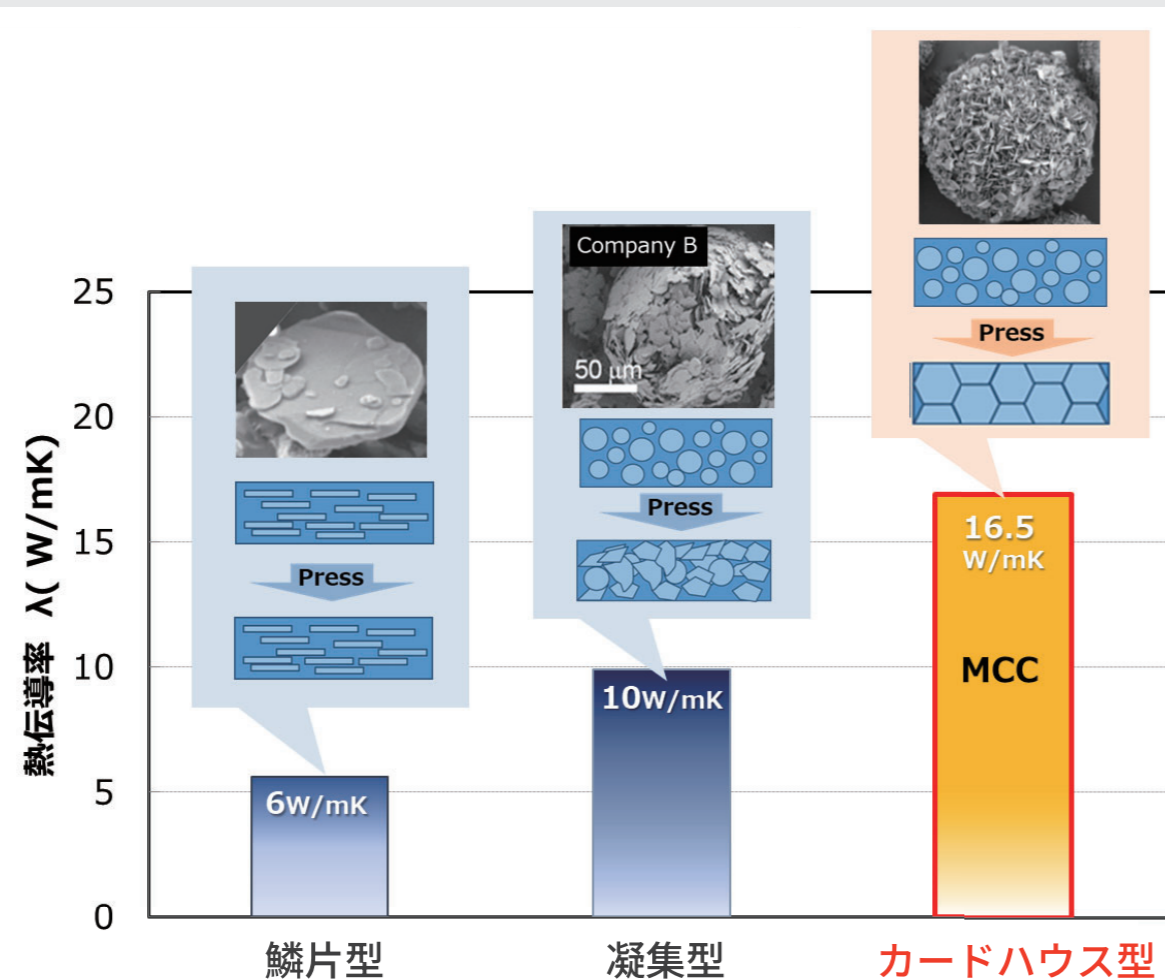
Specification	Typical value
Crystal system	hexagonal
Theoretical density	2.25 g/cc
Volume resistivity	$>10^{12} \Omega \text{ cm}$
Dielectric Constant (誘電率)	3.9
Mohs hardness (モース硬度)	<2
Grain size	40~50 μm (D50)
Thermal stability (熱的安定性)	$>600^\circ\text{C}$ (Air), $>1800^\circ\text{C}$ (inert, vac.)
Hydrolysis resistance (耐加水分解性)	Stable in the atmosphere, water

パワーデバイス向け放熱シートの構成

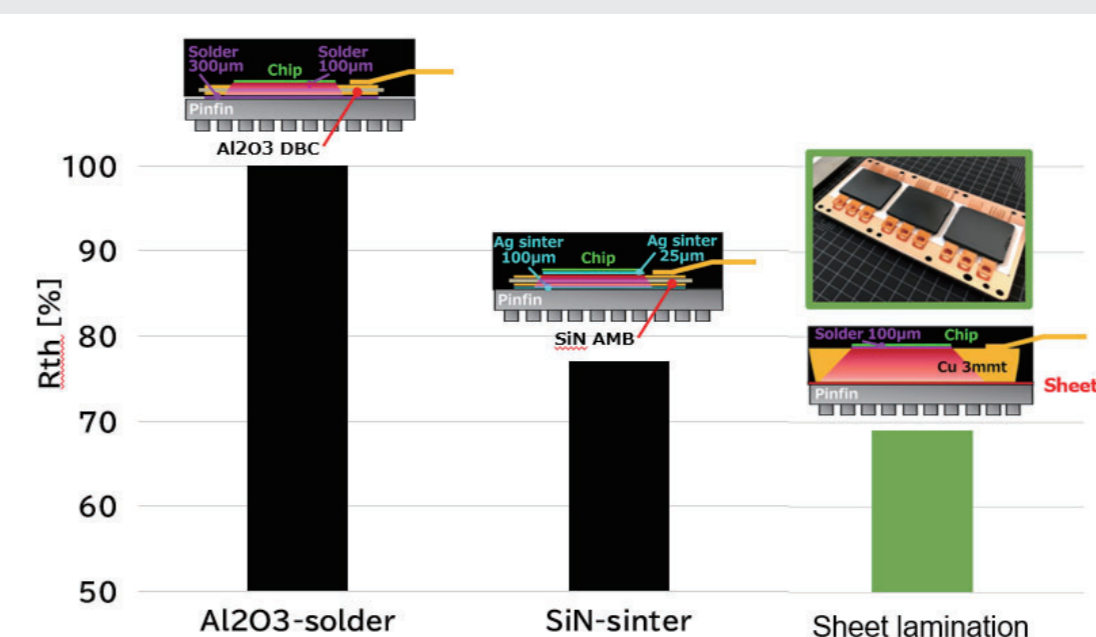


構成、成形条件

- フィラー含有量：**72 wt%**
- バインダー：エポキシ樹脂
- プレス圧力 / 温度：**100 kg/cm², 175 °C**



熱抵抗の比較



取り扱い容易

